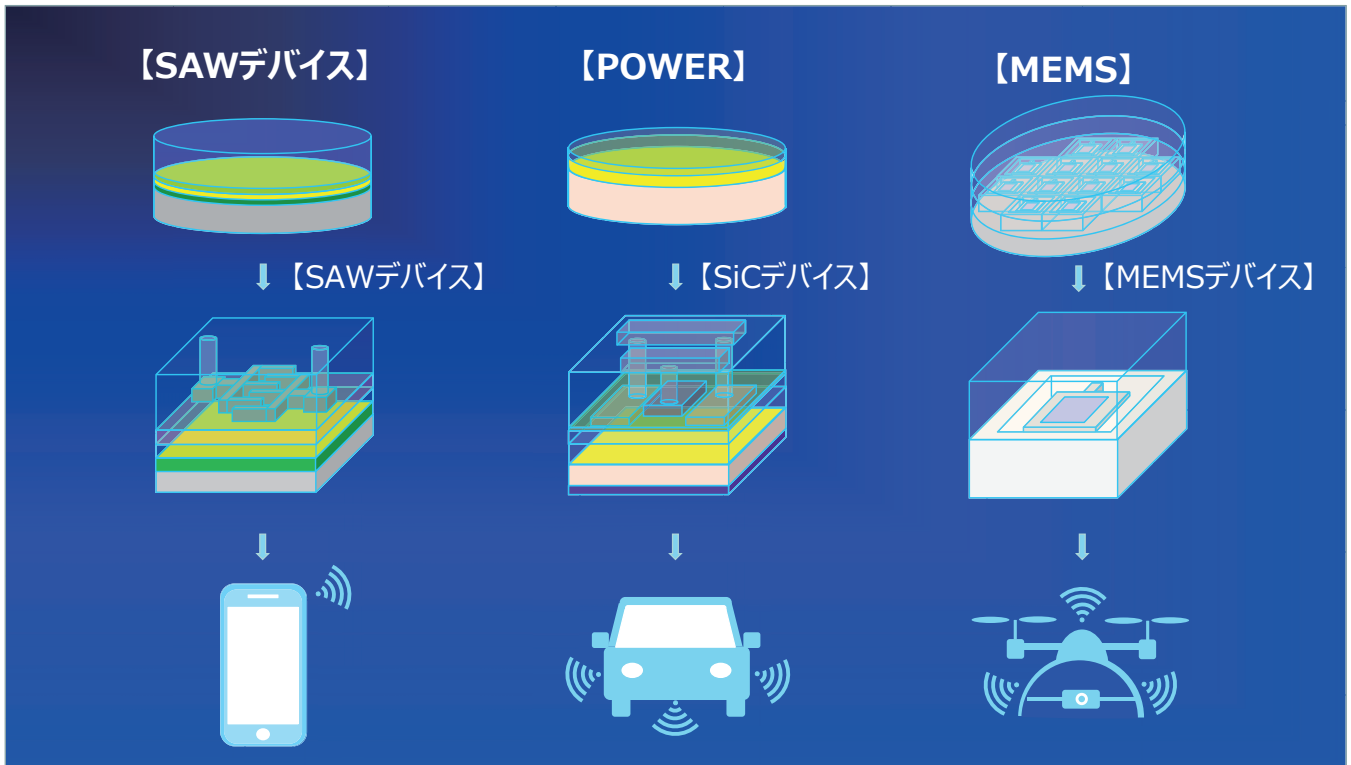




# 未来を支える室温永久接合 原子拡散接合

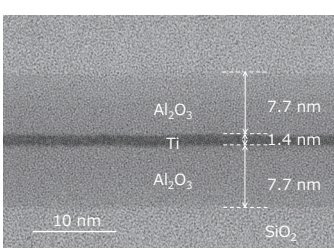
- ✓ 異種材料基板の室温永久接合
- ✓ アプリケーションに応じた接合用スパッタ膜種を選択
- ✓ 接合と同時に真空封止可能

## 【未来を支える原子拡散接合装置の応用例】

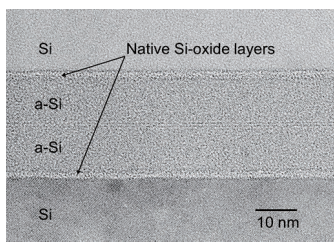


## 【各種接合用スパッタ膜の接合断面TEM】

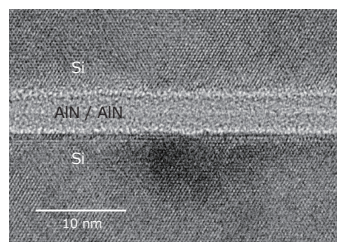
チタン



シリコン\*



窒化アルミ



\* Courtesy of Shimatsu Laboratory, Tohoku University



# 量産用原子拡散接合装置 BC7000シリーズ



BC7300原子拡散接合装置

### 【用途別スパッタリング材料】

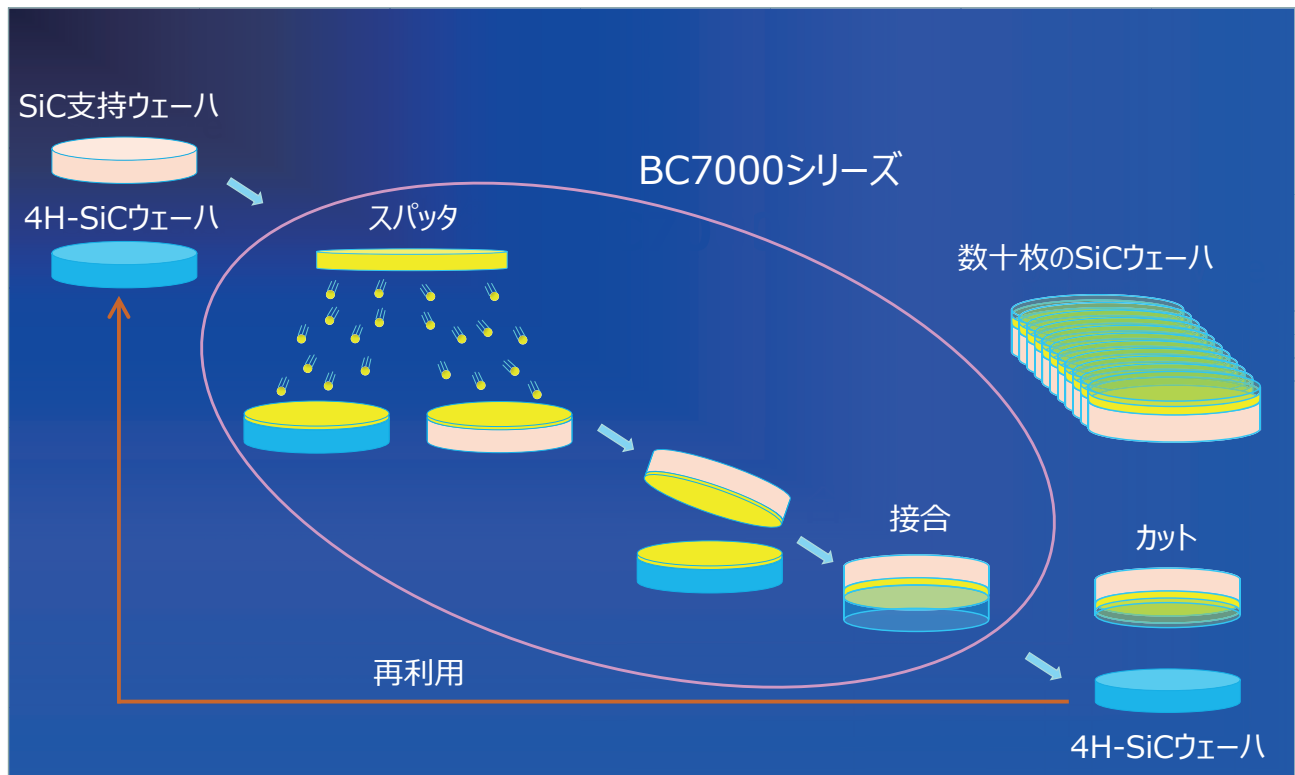
用途	スパッタリング材料		
	Ti	Si	酸化物・化合物 (AlN等)
導電性の接合	✓	✓	
非金属での接合		✓	
接合部の絶縁性確保			✓
接合部の透明性確保			✓

### 【対応基板サイズ】

基板サイズ	BC7000	BC7300
Φ100 mm	✓	
Φ150 mm	✓	
Φ200 mm		✓
Φ300 mm		✓☆

☆ Coming soon

### 【SiC貼り合せプロセスフロー例】



1枚の4H-SiC基板から数十枚のSiC貼り合せ基板が製造可能